

# 吉林华微电子股份有限公司

## 关于将部分房屋抵押贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年7月28日，吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于将部分房屋抵押贷款的议案》，现就相关事宜公告如下：

### 一、抵押贷款基本情况

2019年6月18日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于将部分土地及房屋抵押贷款的议案》，董事会同意公司与中国光大银行股份有限公司吉林分行签订总额为人民币200,000,000.00元的《固定资产暨项目融资借款合同》，并由公司提供房地产抵押担保，合同到期日为2023年6月13日。（详见公司于2019年6月19日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《吉林华微电子股份有限公司关于部分土地及房屋抵押贷款的公告》（2019-039）），此笔贷款业务已如期偿还。

鉴于上述抵押贷款相关合同已到期，并结合公司经营发展需要，公司拟继续向中国光大银行股份有限公司吉林分行申请借款人民币80,000,000.00元，贷款期限十三个月，并由公司提供房地产抵押担保。具体情况如下：

- 1、贷款用途：满足公司业务流动资金需求及经营发展需要；
- 2、贷款额度：人民币80,000,000.00元；
- 3、贷款期限：十三个月，2023年7月27日至2024年8月26日（具体以与银行协商签订的合同为准。）；
- 4、贷款抵押物：公司名下位于吉林市高新区深圳街99号的部分房产【吉林市不动产登记中心颁发的不动产权证书为“吉（2019）吉林市不动产权第0042058号”】，共有宗地面积20,224.48平方米，房屋建筑面积10,359.58平方米。

5、贷款情况：截止到2023年7月31日，公司抵押贷款835,373,000.00元，抵押财产净值821,231,951.62元。

## 二、抵押贷款的必要性及合规性

本次公司以自有资产抵押向银行申请贷款，是公司正常生产经营发展需要，能够满足公司经营发展资金需求。

上述业务贷款事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会授权公司董事长在上述贷款额度和期限内代表公司签署相关法律文件。

## 三、董事会审议情况

2023年7月28日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于将部分房屋抵押贷款的议案》，董事会认为本次抵押贷款属于贷款到期后续贷事项，同意公司与中国光大银行股份有限公司吉林分行签订总额为人民币80,000,000.00元的《抵押合同》，本次资产抵押符合公司和股东的利益需求，不存在损害公司以及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2023年8月1日